

中国

无线音频SoC芯片 投资预测报告（2024-2031年）

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《中国无线音频SoC芯片行业发展趋势分析与未来031年)》涵盖行业最新数据,市场热点,政策规划,竞争情报,市场前景预测,投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,以及我中心对本行业的实地调研,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202409/729145.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

1、无线音频 SoC 芯片概述

得益于无线传输技术的不断迭代更新，无线音频传输芯片大幅改善了人们体验音频的方式。无线音频传输SoC芯片包含完整的硬件电路和配套的嵌入式软件，需要在芯片设计的同时开发对应的应用方案，将复杂的硬件电路和软件系统有效融合以实现产品功能。

无线音频SoC芯片广泛运用于无线耳机、无线音箱、智能可穿戴设备、智能家居等物联网终端设备。随着物联网技术的逐步成熟和应用普及，下游应用场景不断拓展，市场规模持续扩大，市场需求爆发式增长，带动上游芯片行业快速发展。

无线音频SoC芯片行业产业链

数据来源：观研天下整理

无线音频SoC芯片行业发展与下游无线音频终端设备、TWS蓝牙耳机及其智能化发展趋势以及蓝牙、Wi-Fi等无线通信技术的发展状况高度相关。

2、TWS耳机普及，刺激无线音频SoC芯片行业发展

相比传统耳机，TWS耳机内部结构发生较大变化，除了与有线耳机共通的发声单元外，TWS耳机还增加各类传输芯片、传感器、存储芯片、降噪模组等零部件，同时还需要严格控制耳机形状、体积、重量等。

TWS耳机相关零部件

相关零部件

简介

蓝牙音频主控芯片

TWS耳机取消了传统的耳机线连接方式，通过蓝牙技术将耳机与手机等播放设备相连，并通过监听、转发、双通路连接等模式将终端发出的音频信号同时传给两只耳机，组成立体声系统。因此在TWS耳机里，最关键的部件是蓝牙音频主控芯片，它是实现TWS耳机无线连接、音频处理、耳机电源管理、智能交互等功能的基础。

电源管理芯片及充电仓MCU

电源管理芯片被安装在TWS耳机仓内，主要起到两方面作用：一是负责充电仓内部的电池充电，二是负责充电仓内部电池升压输出从而为耳机充电。此外，还需要负责实现安全防护，防止内置锂电池过充、过放、过流、短路等保护功能。

传感器

为了使耳机在穿戴和使用过程中能够更好地对使用者意图做出判断和反应，传感器被大量地使用在TWS耳机中。例如苹果的AirPodsPro、华为的FreeBuds

Pro上均有光学传感器、压力传感器、加速度传感器、骨传导等传感器。

硅麦克风

硅麦克风是一种采用MEMS技术将声学信号转换为电学信号的声学传感器，在TWS耳机中担任识别声音的功能。MEMS（Micro-ElectroMechanical System，微机电系统），是将传统机械系统的部件进行微型化后，通过半导体加工技术，将其固定在晶圆上，制成相应的元器件。硅麦克风主要由MEMS传感器和ASIC芯片两部分构成，传感器将外界信号转换为电信号，执行器与外界产生作用，信号传输单元能够对信号进行处理以及与其他微系统连接。

发声单元

这两种发声单元或独立使用，或组合搭配。使用个数也会根据耳机对音质的要求而有所增减，例如单动圈、单动铁、双动铁、圈铁模组等不同的方案。此外市场上也出现了动瓷喇叭等新兴方案。

电池

TWS耳机中电池存在于两处：一是充电仓，电池主要负责给耳机电池提供备用能源，以及供充电盒内部电路使用，通常为聚合物软包电池，容量在300-600mAh，一般情况下充电盒内只采用一块电池，有长续航或其他特殊功能的产品可能会采用两块；二是左右两只耳机，均需要单独的电池模块，供内部电路、扬声器等元器件使用，通常为纽扣电池、软包电池或针式电池，容量在30-60mAh，选用何种电池主要取决于产品的外观设计和成本考虑。

天线

天线是TWS耳机实现无线连接的重要功能部件之一。天线的作用是将发射机输出的高频电流能量转化为电磁波辐射出去，或者将空间电磁波信号转换成高频电流能量发送给接收机。天线决定了通信质量、信号功率、信号带宽、连接速度等通信指标，是通信系统的重要前端器件。

连接器

目前在TWS耳机里的连接器产品主要有：充电接口、BTB连接器、金属弹片、金属顶针，排线。通过这些连接器TWS耳机能够实现各个元器件之间的连接运行。

资料来源：观研天下整理

2022年以来，由于消费电子需求走弱，叠加TWS耳机渗透率已经达到相对较高水平，全球出货量有所下降。随着消费电子回暖，2024年全球TWS耳机市场有望逐渐恢复至健康状态，整体市场趋于稳定。

数据来源：观研天下整理

随着消费者熟悉度提高，TWS耳机市场趋于平稳，导致厂商更多地依靠价格策略作为实现增长的动能。例如，小米通过进军中低端市场，推出售价低至15美元的产品，市场份额扩大61%，成为全球第二大厂商；华为在海外市场推出首款售价低于30美元的TWS，取得71%的增长；三星将高端ANC技术下放至入门级产品，持续保持市场竞争力。长期来看，随着TWS耳机逐渐普及，刺激无线音频SoC芯片行业发展。

3、蓝牙音响市场复苏迹象显著，为无线音频SoC芯片行业增长提供强劲动力

根据数据显示，2023年，中国蓝牙音响市场销量为2370万台，同比增长 1.9%，销额为66.4亿元，同比增长4.9%，实现了2020年以来的首次正增长，实现复苏，其主要原因是中国出行文旅活动恢复，户外徒步、音乐派对等活动兴起，利好可随身携带的蓝牙音响。

数据来源：观研天下整理

4、智能穿戴设备市场规模不断扩大，持续发力无线音频SoC芯片行业需求增长

智能可穿戴设备集成了多媒体、传感器和无线通信等技术，综合运用各类识别、传感技术、云服务、交互及存储等技术，实现用户交互、生活娱乐、人体监测等功能。随着智能穿戴设备市场规模不断扩大，持续发力无线音频SoC芯片行业需求增长。根据数据显示，2023年，我国智能可穿戴设备行业市场规模达934.7亿元。

数据来源：观研天下整理（WYD）

注：上述信息仅作参考，图表均为样式展示，具体数据、坐标轴与数据标签详见报告正文。

个别图表由于行业特性可能会有出入，具体内容请联系客服确认，以报告正文为准。

更多图表和内容详见报告正文。

观研报告网发布的《中国无线音频SoC芯片行业发展趋势分析与未来031年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。

本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。

本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

【目录大纲】

第一章 2019-2023年中国	无线音频SoC芯片	行业发展概述
第一节	无线音频SoC芯片	行业发展情况概述
一、	无线音频SoC芯片	行业相关定义
二、	无线音频SoC芯片	特点分析
三、	无线音频SoC芯片	行业基本情况介绍
四、	无线音频SoC芯片	行业经营模式
1、生产模式		

2、采购模式

3、销售/服务模式

五、

无线音频SoC芯片

行业需求主体分析

第二节 中国

无线音频SoC芯片

行业生命周期分析

一、

无线音频SoC芯片

行业生命周期理论概述

二、

无线音频SoC芯片

行业所属的生命周期分析

第三节

无线音频SoC芯片

行业经济指标分析

一、

无线音频SoC芯片

行业的赢利性分析

二、

无线音频SoC芯片

行业的经济周期分析

三、

无线音频SoC芯片

行业附加值的提升空间分析

第二章 2019-2023年全球

无线音频SoC芯片

行业市场发展现状分析

第一节 全球

无线音频SoC芯片

行业发展历程回顾

第二节 全球

无线音频SoC芯片

行业市场规模与区域分布情况

第三节 亚洲

无线音频SoC芯片

行业地区市场分析

一、亚洲

无线音频SoC芯片

行业市场现状分析

二、亚洲

无线音频SoC芯片

行业市场规模与市场需求分析

三、亚洲

无线音频SoC芯片

行业市场前景分析

第四节 北美

无线音频SoC芯片

行业地区市场分析

一、北美

无线音频SoC芯片

行业市场现状分析

二、北美

无线音频SoC芯片

行业市场规模与市场需求分析

三、北美

无线音频SoC芯片

行业市场前景分析

第五节 欧洲

无线音频SoC芯片

行业地区市场分析

一、欧洲

无线音频SoC芯片

行业市场现状分析

二、欧洲

无线音频SoC芯片

行业市场规模与市场需求分析

三、欧洲

无线音频SoC芯片

行业市场前景分析

第六节 2024-2031年世界

无线音频SoC芯片

行业分布走势预测

第七节 2024-2031年全球

无线音频SoC芯片

行业市场规模预测

第三章 中国

无线音频SoC芯片

行业产业发展环境分析

第一节 我国宏观经济环境分析

第二节 我国宏观经济环境对

无线音频SoC芯片

行业的影响分析

第三节 中国

无线音频SoC芯片

行业政策环境分析

一、行业监管体制现状

二、行业主要政策法规

三、主要行业标准

第四节 政策环境对

无线音频SoC芯片

行业的影响分析

第五节 中国	无线音频SoC芯片	行业产业社会环境分析
第四章 中国	无线音频SoC芯片	行业运行情况
第一节 中国	无线音频SoC芯片	行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾		
二、行业创新情况分析		
三、行业发展特点分析		
第二节 中国	无线音频SoC芯片	行业市场规模分析
一、影响中国	无线音频SoC芯片	行业市场规模的因素
二、中国	无线音频SoC芯片	行业市场规模
三、中国	无线音频SoC芯片	行业市场规模解析
第三节 中国	无线音频SoC芯片	行业供应情况分析
一、中国	无线音频SoC芯片	行业供应规模
二、中国	无线音频SoC芯片	行业供应特点
第四节 中国	无线音频SoC芯片	行业需求情况分析
一、中国	无线音频SoC芯片	行业需求规模
二、中国	无线音频SoC芯片	行业需求特点
第五节 中国	无线音频SoC芯片	行业供需平衡分析
第五章 中国	无线音频SoC芯片	行业产业链和细分市场分析
第一节 中国	无线音频SoC芯片	行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍		
二、产业链运行机制		
三、	无线音频SoC芯片	行业产业链图解
第二节 中国	无线音频SoC芯片	行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状		
二、上游产业对	无线音频SoC芯片	行业的影响分析
三、下游产业发展现状		
四、下游产业对	无线音频SoC芯片	行业的影响分析
第三节 我国	无线音频SoC芯片	行业细分市场分析
一、细分市场一		
二、细分市场二		
第六章 2019-2023年中国	无线音频SoC芯片	行业市场竞争分析
第一节 中国	无线音频SoC芯片	行业竞争现状分析
一、中国	无线音频SoC芯片	行业竞争格局分析
二、中国	无线音频SoC芯片	行业主要品牌分析
第二节 中国	无线音频SoC芯片	行业集中度分析

一、中国	无线音频SoC芯片	行业市场集中度影响因素分析
二、中国	无线音频SoC芯片	行业市场集中度分析
第三节 中国	无线音频SoC芯片	行业竞争特征分析
一、企业区域分布特征		
二、企业规模分布特征		
三、企业所有制分布特征		
第七章 2019-2023年中国	无线音频SoC芯片	行业模型分析
第一节 中国	无线音频SoC芯片	行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理		
二、供应商议价能力		
三、购买者议价能力		
四、新进入者威胁		
五、替代品威胁		
六、同业竞争程度		
七、波特五力模型分析结论		
第二节 中国	无线音频SoC芯片	行业SWOT分析
一、SOWT模型概述		
二、行业优势分析		
三、行业劣势		
四、行业机会		
五、行业威胁		
六、中国	无线音频SoC芯片	行业SWOT分析结论
第三节 中国	无线音频SoC芯片	行业竞争环境分析（PEST）
一、PEST模型概述		
二、政策因素		
三、经济因素		
四、社会因素		
五、技术因素		
六、PEST模型分析结论		
第八章 2019-2023年中国	无线音频SoC芯片	行业需求特点与动态分析
第一节 中国	无线音频SoC芯片	行业市场动态情况
第二节 中国	无线音频SoC芯片	行业消费市场特点分析
一、需求偏好		
二、价格偏好		
三、品牌偏好		

四、其他偏好

第三节	无线音频SoC芯片	行业成本结构分析
第四节	无线音频SoC芯片	行业价格影响因素分析
一、供需因素		
二、成本因素		
三、其他因素		
第五节 中国	无线音频SoC芯片	行业价格现状分析
第六节 中国	无线音频SoC芯片	行业平均价格走势预测
一、中国	无线音频SoC芯片	行业平均价格趋势分析
二、中国	无线音频SoC芯片	行业平均价格变动的影响因素
第九章 中国	无线音频SoC芯片	行业所属行业运行数据监测
第一节 中国	无线音频SoC芯片	行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析		
二、行业资产规模分析		
第二节 中国	无线音频SoC芯片	行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产		
二、销售收入分析		
三、负债分析		
四、利润规模分析		
五、产值分析		
第三节 中国	无线音频SoC芯片	行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析		
二、行业偿债能力分析		
三、行业营运能力分析		
四、行业发展能力分析		
第十章 2019-2023年中国	无线音频SoC芯片	行业区域市场现状分析
第一节 中国	无线音频SoC芯片	行业区域市场规模分析
一、影响	无线音频SoC芯片	行业区域市场分布的因素
二、中国	无线音频SoC芯片	行业区域市场分布
第二节 中国华东地区	无线音频SoC芯片	行业市场分析
一、华东地区概述		
二、华东地区经济环境分析		
三、华东地区	无线音频SoC芯片	行业市场分析
（1）华东地区	无线音频SoC芯片	行业市场规模
（2）华东地区	无线音频SoC芯片	行业市场现状

(3) 华东地区	无线音频SoC芯片	行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析		
一、华中地区概述		
二、华中地区经济环境分析		
三、华中地区	无线音频SoC芯片	行业市场分析
(1) 华中地区	无线音频SoC芯片	行业市场规模
(2) 华中地区	无线音频SoC芯片	行业市场现状
(3) 华中地区	无线音频SoC芯片	行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析		
一、华南地区概述		
二、华南地区经济环境分析		
三、华南地区	无线音频SoC芯片	行业市场分析
(1) 华南地区	无线音频SoC芯片	行业市场规模
(2) 华南地区	无线音频SoC芯片	行业市场现状
(3) 华南地区	无线音频SoC芯片	行业市场规模预测
第五节 华北地区	无线音频SoC芯片	行业市场分析
一、华北地区概述		
二、华北地区经济环境分析		
三、华北地区	无线音频SoC芯片	行业市场分析
(1) 华北地区	无线音频SoC芯片	行业市场规模
(2) 华北地区	无线音频SoC芯片	行业市场现状
(3) 华北地区	无线音频SoC芯片	行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析		
一、东北地区概述		
二、东北地区经济环境分析		
三、东北地区	无线音频SoC芯片	行业市场分析
(1) 东北地区	无线音频SoC芯片	行业市场规模
(2) 东北地区	无线音频SoC芯片	行业市场现状
(3) 东北地区	无线音频SoC芯片	行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析		
一、西南地区概述		
二、西南地区经济环境分析		
三、西南地区	无线音频SoC芯片	行业市场分析
(1) 西南地区	无线音频SoC芯片	行业市场规模
(2) 西南地区	无线音频SoC芯片	行业市场现状

(3) 西南地区	无线音频SoC芯片	行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析		
一、西北地区概述		
二、西北地区经济环境分析		
三、西北地区	无线音频SoC芯片	行业市场分析
(1) 西北地区	无线音频SoC芯片	行业市场规模
(2) 西北地区	无线音频SoC芯片	行业市场现状
(3) 西北地区	无线音频SoC芯片	行业市场规模预测
第十一章	无线音频SoC芯片	行业企业分析(随数据更新有调整)
第一节 企业		
一、企业概况		
二、主营产品		
三、运营情况		
1、主要经济指标情况		
2、企业盈利能力分析		
3、企业偿债能力分析		
4、企业运营能力分析		
5、企业成长能力分析		
四、公司优势分析		
第二节 企业		
一、企业概况		
二、主营产品		
三、运营情况		
四、公司优劣势分析		
第三节 企业		
一、企业概况		
二、主营产品		
三、运营情况		
四、公司优势分析		
第四节 企业		
一、企业概况		
二、主营产品		
三、运营情况		
四、公司优势分析		
第五节 企业		

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析
- 第六节 企业
- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析
- 第七节 企业
- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析
- 第八节 企业
- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析
- 第九节 企业
- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析
- 第十节 企业
- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第十二章 2024-2031年中国

无线音频SoC芯片

行业发展前景分析与预

第一节 中国

无线音频SoC芯片

行业未来发展前景分析

一、

无线音频SoC芯片

行业国内投资环境分析

二、中国

无线音频SoC芯片

行业市场机会分析

三、中国

无线音频SoC芯片

行业投资增速预测

第二节 中国

无线音频SoC芯片

行业未来发展趋势预测

第三节 中国	无线音频SoC芯片	行业规模发展预测
一、中国	无线音频SoC芯片	行业市场规模预测
二、中国	无线音频SoC芯片	行业市场规模增速预测
三、中国	无线音频SoC芯片	行业产值规模预测
四、中国	无线音频SoC芯片	行业产值增速预测
五、中国	无线音频SoC芯片	行业供需情况预测
第四节 中国	无线音频SoC芯片	行业盈利走势预测
第十三章 2024-2031年中国	无线音频SoC芯片	行业进入壁垒与投资风
第一节 中国	无线音频SoC芯片	行业进入壁垒分析
一、	无线音频SoC芯片	行业资金壁垒分析
二、	无线音频SoC芯片	行业技术壁垒分析
三、	无线音频SoC芯片	行业人才壁垒分析
四、	无线音频SoC芯片	行业品牌壁垒分析
五、	无线音频SoC芯片	行业其他壁垒分析
第二节	无线音频SoC芯片	行业风险分析
一、	无线音频SoC芯片	行业宏观环境风险
二、	无线音频SoC芯片	行业技术风险
三、	无线音频SoC芯片	行业竞争风险
四、	无线音频SoC芯片	行业其他风险
第三节 中国	无线音频SoC芯片	行业存在的问题
第四节 中国	无线音频SoC芯片	行业解决问题的策略分析
第十四章 2024-2031年中国	无线音频SoC芯片	行业研究结论及投资建
第一节 观研天下中国	无线音频SoC芯片	行业研究综述
一、行业投资价值		
二、行业风险评估		
第二节 中国	无线音频SoC芯片	行业进入策略分析
一、行业目标客户群体		
二、细分市场选择		
三、区域市场的选择		
第三节	无线音频SoC芯片	行业营销策略分析
一、	无线音频SoC芯片	行业产品策略
二、	无线音频SoC芯片	行业定价策略
三、	无线音频SoC芯片	行业渠道策略
四、	无线音频SoC芯片	行业促销策略
第四节 观研天下分析师投资建议		

图表详见报告正文

详细请访问：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202409/729145.html>